

株主・投資家の皆様へ 第78期中間報告書

平成25年4月1日 ▶ 平成25年9月30日

目次

ごあいさつ	1
製品別の売上概況	3
販売の状況	5
連結貸借対照表	7
連結損益計算書	8
連結キャッシュ・フロー計算書/個別業績の概要	9
株主還元	10
トピックス	11
会社概要/役員および執行役員	13
株式の状況	14

Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所

証券コード：6981

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。第78期（平成26年3月期）の中間報告書をお届けするにあたり、当社グループの業績概要についてご報告申し上げます。

第2四半期連結累計期間の業績について

当第2四半期累計期間の世界の経済情勢は、米国では雇用や住宅市場などで緩やかながら改善傾向が続いているものの、欧州では財政問題に起因する経済の低迷が継続しており、中国をはじめとした新興国では成長率の鈍化傾向が続きました。

当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、従来型PCやAV機器で生産台数の減少が見られたものの、スマートフォンやタブレット端末が引き続き大きく成長したほか、自動車の生産台数増加や電装化の進展などにより、全体では電子部品の需要は増加しました。

このような市場環境のもと、当社は伸びる市場に注力し、当第2四半期累計期間の売上高は、円安効果（前年同期比19円44銭の円安）もあり、前年同期比31.6%増の

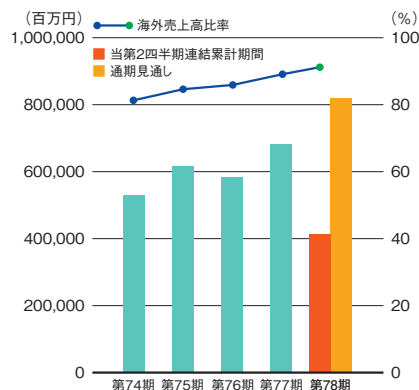
414,131百万円と半期ベースで過去最高となりました。四半期ベースで見ましても、第2四半期会計期間の売上高は、前四半期比15.0%増の221,550百万円となり、2四半期連続で過去最高値を更新しました。

利益につきましては、生産能力の増強に伴う固定費の増加、製品価格の値下がりといった減益要因はありましたが、操業度益やコストダウン、円安効果が大きく、営業利益は前年同期比176.9%増の67,419百万円、税引前四半期純利益は同196.9%増の68,349百万円、四半期純利益は同215.0%増の47,649百万円と大幅な増益となり、営業利益率は前年同期に比べ8.6ポイント上昇の16.3%と大きく改善しました。

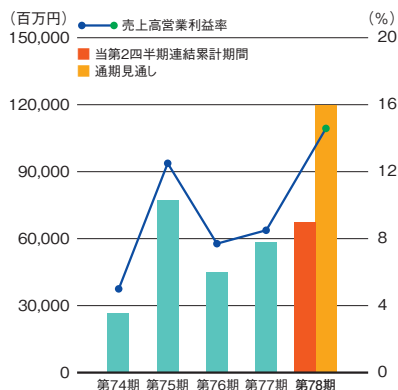
通期業績の見通し

当社を取り巻く市場環境は、スマートフォンの成長、タブレット端末の拡大、自動車の生産台数増加や電装化の進展などにより、電子部品の需要は好調に推移しております。現時点での部品需要見通しと、生産能力の増強に伴う固定費の増加や製品価格の値下がりといった利益

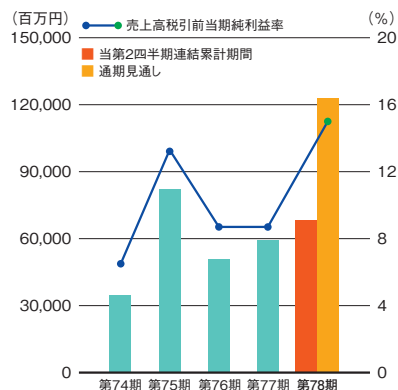
■売上高 / 海外売上高比率



■営業利益 / 売上高営業利益率



■税引前当期純利益 / 売上高税引前当期純利益率



変動要因を鑑み、平成26年3月期の業績見通しについて、売上高を820,000百万円（前年度比20.4%増）、営業利益を120,000百万円（同104.7%増）、税引前当期純利益を123,000百万円（同106.6%増）、当期純利益を86,000百万円（同102.9%増）と上方修正いたしました。

株主還元策について

株主の皆様への利益還元策としては、配当による成果の配分を優先的に考え、長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針としております。この方針に基づき、連結ベースでの業績と配当性向並びに内部留保の蓄積などを総合的に勘案したうえで、配当による利益還元を行っております。

また、当社は自己株式の取得につきましても株主の皆様への利益還元策としてとらえており、資本効率の改善を目的に適宜実施しております。

中間配当金は、当上半期の業績だけではなく内部留保の蓄積を鑑み、期初に予定していたとおり、1株当たり

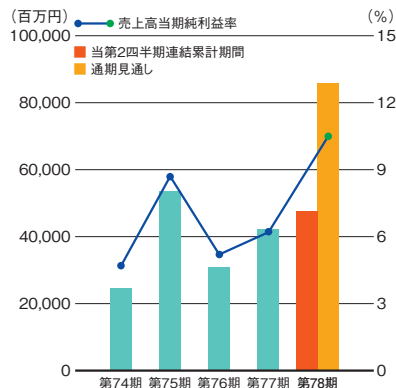
60円とさせていただきます。また、当期末配当金につきましても、中間配当金と同様の1株当たり60円とし、年間配当金は120円を予定しております。なお、この1株当たり配当金は、10月末日時点の事業環境及び通期の業績見通しによるものです。

（注）業績予想の前提条件及び注意事項については当社第2四半期決算短信6、7ページをご参照ください。第2四半期決算短信は当社ホームページでもご覧いただけます。

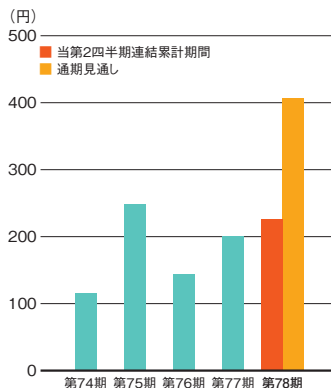


代表取締役社長 村田 恒夫

■当期純利益 / 売上高当期純利益率

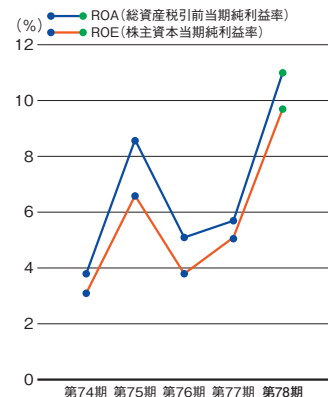


■1株当たり当期純利益



■ROA / ROE

※第78期は通期見直し値を示しています。



製品別の売上概況

当第2四半期連結累計期間の製品別の売上高を前年同四半期連結累計期間と比較した概況は、以下のとおりです。

コンポーネント

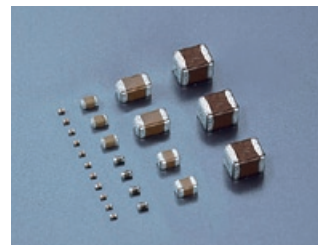
当第2四半期累計期間のコンポーネントの売上高は、前年同期に比べ23.8%増の265,274百万円となりました。

コンデンサ

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当第2四半期累計期間は、主力の積層セラミックコンデンサが、通信機器向けで主に携帯電話の生産台数増加と高機能化の進展、カーエレクトロニクス向けで自動車の生産台数増加と電装化の進展により需要が増加し、全体で大きく伸長しました。

その結果、コンデンサの売上高は、前年同期に比べ27.1%増の138,424百万円となりました。



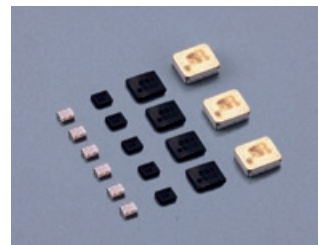
チップ積層セラミックコンデンサ

圧電製品

この区分には、表面波フィルタ、発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当第2四半期累計期間は、表面波フィルタが（高周波回路のモジュール化の進展により通信モジュールセグメント向けの社内取引の割合が高まったものの）、携帯電話の生産台数増加とマルチバンド化に伴う携帯電話1台当たりの搭載点数増加により非常に好調でした。圧電センサは、ショックセンサが、ハードディスクドライブ向けに搭載点数の増加により大きく伸長しました。発振子は、家電・その他向けやカーエレクトロニクス向けで好調でした。

その結果、圧電製品の売上高は、前年同期に比べ25.0%増の48,543百万円となりました。



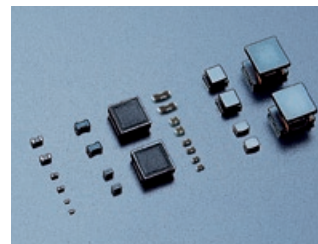
表面波フィルタ

その他コンポーネント

この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、コネクタ、センサ、サーミスタなどが含まれます。

当第2四半期累計期間は、EMI除去フィルタが、カーエレクトロニクス向けや通信向けで好調でした。コイル及びコネクタは、携帯電話向けを中心に大幅に増加しました。センサは、MEMSセンサが、カーエレクトロニクス向けで大きく伸長しました。

その結果、その他コンポーネントの売上高は、前年同期に比べ17.7%増の78,307百万円となりました。



チップフェライトビーズ／
チップコモンモードチョークコイル／
エミフィル®／チップコイル

モジュール

当第2四半期累計期間のモジュールの売上高は、前年同期に比べ48.7%増の147,506百万円となりました。

通信モジュール

この区分には、近距離無線通信モジュール、通信機器用モジュール、多層モジュール、多層デバイスなどが含まれます。

当第2四半期累計期間は、近距離無線通信モジュールが、携帯電話、タブレット端末向けに大幅に増加しました。通信機器用モジュール及び多層モジュールは、新製品の投入もあり携帯電話向けが飛躍的に増加したことで、前年同期を大幅に上回りました。多層デバイスは、携帯電話向けに大きく伸長しました。

その結果、通信モジュールの売上高は、前年同期に比べ58.5%増の119,714百万円となりました。



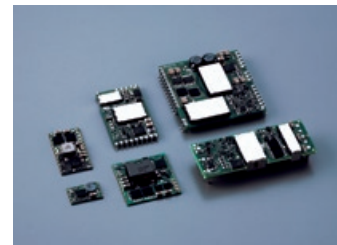
無線LAN向けモジュール
(Wi-Fiモジュール)

電源他モジュール

この区分には、電源などが含まれます。

当第2四半期累計期間は、電源がサーバーやカーエレクトロニクス向けに大きく伸長しました。

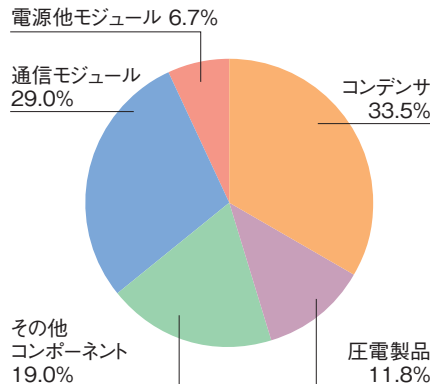
その結果、電源他モジュールの売上高は、前年同期に比べ17.4%増の27,792百万円となりました。



DC-DCコンバータ

販売の状況

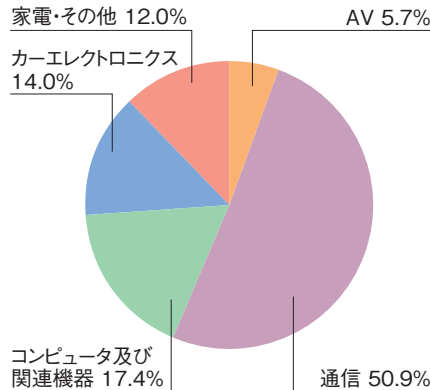
製品別売上高



(単位: 百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間		当第2四半期 連結累計期間		増 減	
	(平成24年4月1日 ～平成24年9月30日)	構成比 (%)	(平成25年4月1日 ～平成25年9月30日)	構成比 (%)		増減率 (%)
コンデンサ	108,885	34.8	138,424	33.5	29,539	27.1
圧電製品	38,822	12.4	48,543	11.8	9,721	25.0
その他コンポーネント	66,550	21.2	78,307	19.0	11,757	17.7
コンポーネント計	214,257	68.4	265,274	64.3	51,017	23.8
通信モジュール	75,541	24.1	119,714	29.0	44,173	58.5
電源他モジュール	23,667	7.5	27,792	6.7	4,125	17.4
モジュール計	99,208	31.6	147,506	35.7	48,298	48.7
製品売上高計	313,465	100.0	412,780	100.0	99,315	31.7

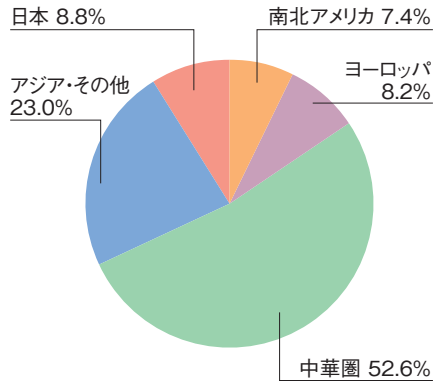
用途別売上高 (当社推計値に基づいております)



(単位: 百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間		当第2四半期 連結累計期間		増 減	
	(平成24年4月1日 ～平成24年9月30日)	構成比 (%)	(平成25年4月1日 ～平成25年9月30日)	構成比 (%)		増減率 (%)
AV	23,829	7.6	23,534	5.7	△295	△1.2
通信	142,232	45.4	210,270	50.9	68,038	47.8
コンピュータ及び関連機器	64,475	20.6	71,629	17.4	7,154	11.1
カーエレクトロニクス	50,870	16.2	57,776	14.0	6,906	13.6
家電・その他	32,059	10.2	49,571	12.0	17,512	54.6
製品売上高計	313,465	100.0	412,780	100.0	99,315	31.7

地域別売上高



(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間		当第2四半期 連結累計期間		増 減	
	(平成24年4月1日 ～平成24年9月30日)	構成比 (%)	(平成25年4月1日 ～平成25年9月30日)	構成比 (%)		増減率 (%)
南北アメリカ	19,488	6.2	30,593	7.4	11,105	57.0
ヨーロッパ	32,599	10.4	33,851	8.2	1,252	3.8
中華圏	164,273	52.4	216,992	52.6	52,719	32.1
アジア・その他	57,677	18.4	94,872	23.0	37,195	64.5
海外計	274,037	87.4	376,308	91.2	102,271	37.3
日本	39,428	12.6	36,472	8.8	△2,956	△7.5
製品売上高計	313,465	100.0	412,780	100.0	99,315	31.7

用語解説

■コンデンサ（3ページ）

コンデンサは電気を蓄える働きをし、電源の電圧変動を吸収して電子機器の安定動作に貢献する役割を担う部品です。携帯電話、パソコン、デジタル家電など、多くの電子機器に使われています。

■フィルタ（表面波/セラミック/EMI除去）（3ページ）

コーヒ어의フィルタでイメージできるように、必要な信号だけ通し、不要な信号を通さない働きをします。表面波フィルタ、セラミックフィルタは特定の信号だけを通す役割をし、EMI除去フィルタは信号に含まれるノイズ（EMI=Electromagnetic Interference）を除去して電子回路を守ります。

■発振子（3ページ）

電子機器にはプロセッサやマイコンなどのデジタルICが多数使われています。発振子は、それらのデジタル信号処理を正しく動作させるために、テンポを制御する「基準クロック信号」を発生させる電子部品です。

■サーミスタ（3ページ）

サーミスタとは、温度により抵抗値が変化するセラミックの抵抗体です。電子機器の小型化・高出力化が年々進む中、機器の機能だけでなく、機器の安全性・安定性対策にサーミスタ機能のニーズが高まっており、過熱検知・過電流保護・温度補償などの用途に展開されています。

■MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）（3ページ）

半導体の微細加工技術を用いて作製された微小な部品から構成される電気機械システムです。ジャイロセンサや加速度センサ等に応用されています。

■多層デバイス（4ページ）

従来は1枚の基板上に多数の部品を実装して構成していた回路を、セラミックシートを何層も重ねて形成した多層セラミックスの内部に3次元で回路を構成し、部品の機能を作り込むことによって、小型化を実現した電子部品です。

連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末		当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成25年3月31日)		(平成25年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)	(1,087,144)	(100.0)	(1,154,710)	(100.0)
流動資産	538,098	49.5	632,416	54.8
① 現金及び預金	77,444		73,862	
① 短期投資	46,521		78,000	
② 有価証券	60,752		92,148	
受取手形	833		559	
売掛金	164,047		178,731	
貸倒引当金	△941		△966	
たな卸資産	160,934		175,280	
繰延税金資産	19,173		23,043	
前払費用及びその他の流動資産	9,335		11,759	
有形固定資産	323,922	29.8	334,989	29.0
土地	46,887		48,114	
建物及び構築物	297,558		308,562	
機械装置及び工具器具備品	679,204		713,711	
建設仮勘定	20,043		18,996	
減価償却累計額	△719,770		△754,394	
投資及びその他の資産	225,124	20.7	187,305	16.2
関連会社に対する投資	2,225		—	
② 投資	157,858		121,593	
のれん	12,765		13,921	
繰延税金資産	7,499		7,583	
その他の固定資産	44,777		44,208	
合 計	1,087,144	100.0	1,154,710	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末		当第2四半期 連結会計期間末	
	(平成25年3月31日)		(平成25年9月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	(226,181)	(20.8)	(238,777)	(20.7)
流動負債	153,125	14.1	162,677	14.1
短期借入金	47,061		41,702	
買掛金	38,935		42,248	
未払給与及び賞与	24,011		27,008	
未払税金	11,555		22,533	
未払費用及びその他の流動負債	31,563		29,186	
固定負債	73,056	6.7	76,100	6.6
長期債務	7,443		8,402	
退職給付引当金	63,562		64,761	
繰延税金負債	879		1,431	
その他の固定負債	1,172		1,506	
(資本の部)	(860,963)	(79.2)	(915,933)	(79.3)
資本金	69,377		69,377	
資本剰余金	102,396		103,863	
利益剰余金	764,485		801,580	
その他の包括利益(△損失)累計額	△12,221		1,376	
有価証券未実現損益	5,695		7,365	
年金負債調整勘定	△3,982		△4,060	
デリバティブ未実現損益	△165		—	
為替換算調整勘定	△13,769		△1,929	
自己株式(取得原価)	△63,074		△60,263	
合 計	1,087,144	100.0	1,154,710	100.0

Point

前連結会計年度末からの主な増減要因

①「現金及び預金」「短期投資」(27,897百万円)の増加

主に需要増加による一時的な運転資金の変動に対応したことによるものです。

②「有価証券」(31,396百万円)の増加及び「投資」(△36,265百万円)の減少

主に1年内償還債券を「投資」から「有価証券」へ振り替えたことによるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別		前第2四半期 連結累計期間 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)		当第2四半期 連結累計期間 (平成25年4月1日～平成25年9月30日)	
			金 額	百分比	金 額	百分比
				%		%
売上高			314,683	100.0	414,131	100.0
売上原価			222,793	70.8	268,091	64.7
販売費及び一般管理費			44,381	14.1	52,088	12.6
研究開発費			23,157	7.4	26,533	6.4
営業利益			24,352	7.7	67,419	16.3
受取利息及び配当金			1,854	0.5	2,444	0.6
支払利息			△137	△0.0	△152	△0.1
為替差損			△1,719	△0.5	△1,018	△0.2
その他（純額）			△1,332	△0.4	△344	△0.1
税引前四半期純利益			23,018	7.3	68,349	16.5
法人税等			8,001	2.5	20,619	5.0
（法人税、住民税及び事業税）			(10,271)		(25,129)	
（法人税等調整額）			(△2,270)		(△4,510)	
持分法投資損益			112	0.0	△81	△0.0
四半期純利益			15,129	4.8	47,649	11.5

Point

売上高は、従来型PCやAV機器で生産台数の減少が見られたものの、スマートフォンやタブレット端末が引き続き大きく成長したほか、自動車の生産台数増加や電装化の進展などにより、全体では前年同期比31.6%増の414,131百万円と半期ベースで過去最高となりました。利益につきましては、生産能力の増強に伴う固定費の増加、製品価格の値下がりといった減益要因はありましたが、操業度益やコストダウン、円安効果が大きく、営業利益は前年同期比176.9%増の67,419百万円、税引前四半期純利益は同196.9%増の68,349百万円、四半期純利益は同215.0%増の47,649百万円と大幅な増益となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(平成24年4月1日～平成24年9月30日)	(平成25年4月1日～平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,099	72,883
投資活動によるキャッシュ・フロー		△23,566	△30,480
財務活動によるキャッシュ・フロー		966	△18,414
換算レート変動による影響		△284	1,071
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		△13,785	25,060
現金及び現金同等物の期首残高		65,302	90,068
現金及び現金同等物の四半期末残高		51,517	115,128

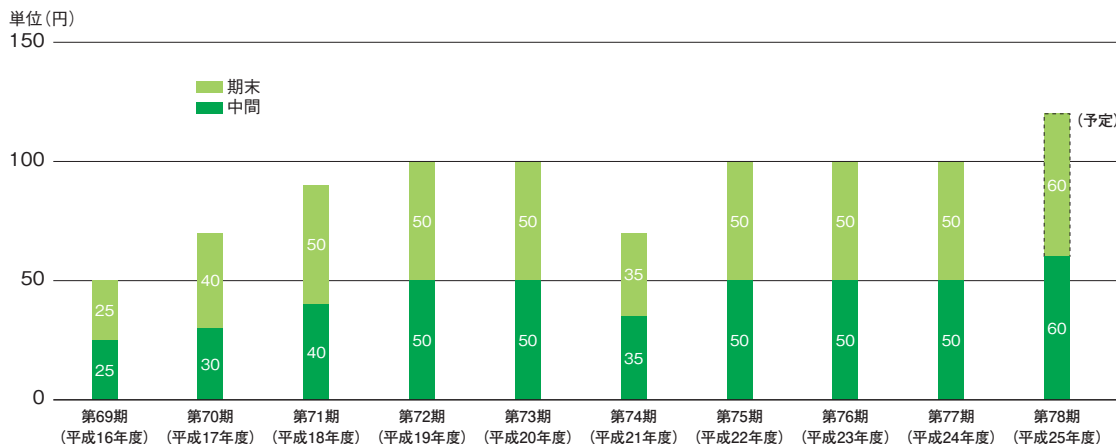
個別業績の概要

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間
		(平成24年4月1日～平成24年9月30日)	(平成25年4月1日～平成25年9月30日)
売上高		257,845	324,535
営業利益		518	21,789
経常利益		9,384	32,949
四半期純利益		9,562	27,712
総資産		590,561	668,200
純資産		383,491	421,052
1株当たり四半期純利益(円)		45.31	131.16

株 主 還 元

■ 1株当たり配当金の推移



■ 自己株式の取得

当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成14年度～平成24年度の間に167,857百万円、33,272千株の自己株式を取得し、19,000千株を消却しました。

ウェアラブルコンピュータ向け水晶振動子の商品化

今年8月1日に完全子会社化した東京電波株式会社（以下、東京電波）との共同開発品として、2016サイズ（2.0×1.6mm）の水晶振動子*1「XRCGDシリーズ」を商品化しました。

2009年に、東京電波との共同開発品として水晶振動子「HCR®」を初めて商品化し、これまで当社がセラミック発振子で得意としていた車載、民生用途に加え、比較的高精度が要求されるHDD（ハードディスクドライブ）市場で採用を拡大してきました。今回商品化したXRCGDシリーズは、合金による融着封止工法を採用することにより、高い精度が求められる無線通信用途での対応が可能となりました。部品の小型化が求められる携帯機器やウェアラブルコンピュータ*2市場での搭載が進むと期待できます。

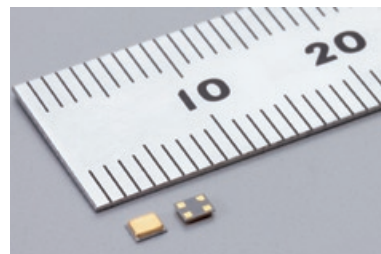
さらに今後は、モバイル機器市場への本格参入を目指すべく、より小さな水晶振動子やサーミスタ付き水晶振動子*3、TCXO*4などを展開していきます。

*1 振動子：固有の周波数で振動する電子部品。デジタル回路のクロック信号源として使われます。水晶の圧電特性を利用した振動子は「水晶振動子」と呼ばれ、精度の高い信号を送ることができます。

*2 ウェアラブルコンピュータ：身につけて持ち歩くことのできるコンピュータ。

*3 サーミスタ付き水晶振動子：水晶振動子とサーミスタを一つのパッケージに組み込んだ商品。水晶振動子により近い位置の温度を検出することができます。

*4 TCXO：水晶振動子と温度補償回路を一つのパッケージに組み込んだ発振器。温度補償回路に水晶振動子を持つ温度特性と正反対の特性を持たせることで、非常に高い温度特性を得ることができます。



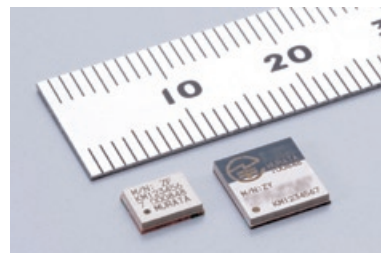
水晶振動子 XRCGDシリーズ

世界最小! 5.4×4.4mmサイズのBluetooth® Smartモジュールの開発

Bluetooth® Smart*は、コイン電池で数か月から数年間使用できる超低消費電力の通信技術です。スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末への採用が広がっており、活動量計・体重計等の健康管理機器や、腕時計・小型センサ等の電池駆動機器とこれらのモバイル端末とをシームレスに接続する手段として、今後大きく市場が広がることが期待されています。特に最近注目が集まっている眼鏡型デバイスや腕輪型活動量計等のウェアラブルコンピュータでは、小型化や低消費電力へのニーズが非常に高まっています。当社はこのような市場からの要求に応えるために、サイズ・消費電力が当社従来比4分の1の、超小型・超低消費電力Bluetooth® Smartモジュールを開発しました。

*Bluetooth® Smart：Bluetooth® の低消費電力版であるBluetooth® low energyをサポートした機器向けであることを示します。Bluetooth® およびBluetooth® low energyは2.4GHz帯の電波を使った免許不要の近距離無線通信方式です。

※Bluetooth® はBluetooth Special Interest Group（SIG）によって規格が規定されています。



Bluetooth® Smartモジュール

世界初、世界最小チップフェライトビーズ 0201サイズ (0.25×0.125mm) の開発

スマートフォンをはじめとする小型モバイル機器のマルチバンド化、高機能化により、電子部品の搭載点数はますます増加し、高密度実装を支える超小型部品へのニーズは高まっています。そうしたなか、当社は昨年、世界で初めて世界最小0201サイズ (0.25×0.125mm) の積層セラミックコンデンサおよびチップインダクタを開発しました。そしてこのたび、電子機器のノイズ対策として必要とされるチップフェライトビーズ* においても、独自の最新微細加工技術の応用により、世界で初めて0201サイズの開発に成功しました。現在一部のスマートフォンに搭載されている0402サイズ (0.4×0.2mm) と比べて、体積を75%削減できました。

今回、この0201サイズのチップフェライトビーズを開発したことで、あらゆる電子機器で必要となる主要な機能の電子部品を超小型サイズで取り揃えることができました。今後の電子機器の高機能化、小型化の進展に寄与するものと確信しています。

*チップフェライトビーズ：EMI除去フィルタの一種で、フェライトの損失を利用して電子機器から発生するノイズを除去します。電子機器の誤動作防止に役立っています。



0201サイズのチップフェライトビーズ(右端)

日越国交40周年記念「日本ものづくり技術展」にムラタセイサク君® が参加

日越国交40周年を記念し、今年9月4日から6日にかけて、大型イベントがハノイ国際展示場 (I.C.E.) にて開催されました。世界25か国から200企業・500ブランドが参加し、3日間で約13,000人の人々が訪れ、ビジネスネットワークを広げました。

ベトナムは、各企業の投資先として注目されており、今後は、通信、OA、自動車、AV、家電、エネルギー・環境といった分野を中心に、電化製品の製造拠点としてさらに重要性が高まっていくとみられます。とりわけ家電分野が非常に大きな成長の可能性を秘めており、電化製品の需要を牽引していくことが期待されています。

当社の子会社であるMurata Electronics (Vietnam) Co., Ltd. (ベトナム・ハノイ) は、ベトナムにセールスオフィスを構えた最初で唯一の受動部品メーカーです。今回、日本貿易振興会 (JETRO) からの招待を受け、「日本ものづくり技術展」に出展しました。ブース展示とともに、ムラタセイサク君® の実演もおこない、最先端の技術を目の前にした大勢の観客から高い評価を受けました。この展示会を通じてより多くのベトナムのお客様やメディアに接することで、ムラタブランドとその商品群をアピールし、企業関係者により親密な協力関係を築くことができました。



ムラタセイサク君®の実演の様子

会社概要

平成25年 9月30日現在

- 商 号 株式会社 村田製作所
Murata Manufacturing Co., Ltd.
- 設 立 昭和25年12月23日（創業 昭和19年10月）
- 資 本 金 69,377百万円
- 従業員数 連結 37,995名 個別 7,358名
- 所 在 地 本 社 〒617-8555京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 電話 075-951-9111
支 社 東京支社・東京都渋谷区
事業所 長岡事業所・京都府長岡京市/八日市事業所・滋賀県東近江市/野洲事業所・滋賀県野洲市/横浜事業所・横浜市緑区
営業所 仙台/水戸/さいたま/東京/立川/浜松/名古屋/安曇野/京都/神戸/岡山/福岡
- 国内関係会社 27社
- 海外関係会社 52社

役員および執行役員

平成25年 9月30日現在

代表取締役

取締役社長 村 田 恒 夫
取締役副社長 藤 田 能 孝

取締役

村 田 恒 夫
藤 田 能 孝
牧 野 孝 次
中 島 規 巨
竹 村 善 人
棚 橋 康 郎（社外取締役）
吉 原 寛 章（社外取締役）

監査役

常勤監査役 吉 野 幸 夫
田 中 純 一
監査役 豊 田 正 和（社外監査役）
中 西 倭 夫（社外監査役）
西 川 和 人（社外監査役）

執行役員

上席常務執行役員 牧 野 孝 次
濱 地 幸 生
常務執行役員 井 上 亨
中 島 規 巨
上席執行役員 小 島 祐 一
蘭 田 聡
岩 坪 浩
執行役員 岡 田 剛 和
前 川 利 弘
竹 村 善 人
鴻 池 健 弘
丸 山 英 毅
多 田 裕
石 谷 昌 弘
水 野 健 一
石 野 聡
フェロー 酒 井 範 夫
執行役員 宮 本 隆 二

株式の状況

平成25年9月30日現在

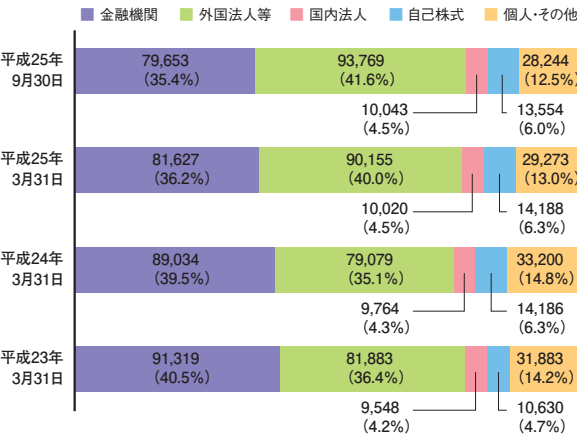
株式事項

発行済株式総数 225,263千株
株主数 69,835名

株式上場

[国内] [海外]
東京証券取引所 市場第一部 シンガポール証券取引所

所有者別分布状況(千株)



大株主の状況

順位	株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
1	ジェービー モルガン チェース バンク 380055	21,423	10.1
2	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	12,813	6.1
3	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口)	9,005	4.3
4	日本生命保険相互会社	8,522	4.0
5	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	6,403	3.0
6	株式会社京都銀行	5,260	2.5
7	明治安田生命保険相互会社	5,240	2.5
8	株式会社滋賀銀行	3,551	1.7
9	株式会社みずほ銀行	3,000	1.4
10	ザ バンク オブ ニューヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント	2,839	1.3

(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(13,553千株)を除いて計算しております。

株 主 メ モ

■ 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

■ 剰余金の配当基準日

中間配当金 9月30日
期末配当金 3月31日

■ 単元株式数

100株

■ 公告の方法

当社ウェブサイトに掲載いたします。
(<http://www.murata.co.jp/>)
ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

■ 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関	東京都中央区八重洲一丁目2番1号
事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 ※1
郵便物送付／電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324 (通話料無料)
旧東京電波株式会社の株式に係る特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ※2

■ お取扱窓口について

お手続き内容		お問い合わせ先
・住所・名義の変更 ・単元未満株式の買取・買増請求 ・配当金受取り方法のご指定 ・相続に伴うお手続き 他	証券会社等に口座をお持ちの場合	お取引のある証券会社等
	証券会社等に口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合) ※3	みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ※4 または 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ※2
・未払い配当金のお支払い	すべての株主様	みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほ証券株式会社 本店および全国各支店 株式会社みずほ銀行 本店および全国各支店

※1 平成25年12月24日から事務取扱場所が次のとおり変更となります。

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

※2 当社と東京電波株式会社の株式交換の効力発生日の前日である平成25年7月31日において、東京電波株式会社の株式を特別口座で
お持ちであった株主様につきましては、引き続き三菱UFJ信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっております。

※3 特別口座では、株式の売却はできません。売却するには、証券会社等にお取引きの口座を開設し、株式の振替手続きが必要となります。

※4 お取扱店は次のとおりです。

みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店

みずほ証券株式会社 本店および全国各支店

当社では、単元未満株式の買取・買増に関する手数料を無料としておりますので、ぜひご活用ください。

(お取引証券会社等で株式を管理している場合は、お取引証券会社等で別途手数料のかかる場合がございます。)



Innovator in Electronics



株式会社 村田製作所